

★最先端半導体の開発に対応したパッケージ基板設計、微細接続技術、微細配線形成技術について分かりやすく解説します！

チップレット・光電融合時代に求められる 半導体パッケージ基板設計

◆日 時：2026年1月27日(火) 13:00～16:30

【アーカイブ配信：1/29～2/5】

◆受講料：1名につき49,500円(税込、資料付)※LIVE/アーカイブ配信いずれかの料金です。

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

- ・1名でお申込みされた場合、1名につき**39,600円**
- ・2名同時にお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で49,500円)**
- ・LIVE/アーカイブ両方視聴する場合は、**1名で49,500円(税込)、2名同時申込で55,000円(税込)になります。**

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

【講師】※ご略歴はホームページでご確認下さい。

千歳科学技術大学 大学院理 工学研究科

准教授 博士(工学) 大島 大輔 氏

<ご専門> 半導体実装設計

<学協会> エレクトロニクス実装学会、電子情報通信学会、日本AEM学会

【習得知識】

- ・半導体パッケージ基板設計技術(信号品質、電源品質)
- ・ハイブリッドボンディングなどの微細接続技術開発の必要性
- ・RDLなどの微細配線形成技術開発の必要性
- ・高周波特性が良好な材料開発の必要性

【講座の趣旨】

最近、半導体業界ではAIなどの演算処理能力向上のニーズに応えるため、光電融合技術やチップレット技術の研究開発が盛んになっている。従来の半導体デバイスは、微細化による高集積化により性能向上が図られていた。しかし、性能向上のニーズは微細化の限界を超えたため、デバイスを複数(チップレット)に分割して半導体パッケージ基板上で電気または光で接続する形態へと変化した。

このようなチップレット・光電融合時代においては、半導体パッケージ基板の配線設計技術の重要性が急速に増している。さらに、半導体パッケージ基板の配線密度は半導体デバイス並みになることが要求されるため、単に配線設計技術が難化するだけでなく、微細配線形成技術と微細接続技術の開発が不可欠である。

そこで本セミナーでは、チップレット・光電融合時代の半導体パッケージ基板を設計技術の立場から解説する。

【プログラム】※詳細内容はホームページでご確認下さい。

- 最先端半導体とチップレット
 - 1-1 微細化と高集積化
 - 1-2 マルチチップモジュールとチップレット
 - 1-3 チップレットの必要性
 - 1-4 光電融合の必要性
 - 1-5 大量少品種と少量多品種
 - 1-6 DFMとMFD
- チップレット・光電融合向け半導体パッケージ基板
 - 2-1 2-xD集積技術
 - 2-2 3D集積技術
 - 2-3 光電融合技術
 - 2-4 高速伝送設計とシミュレーション技術
- 高密度配線を実現する実装技術
 - 3-1 設計ルールとファンアウト配線
 - 3-2 Re-distribution Layer (RDL)技術
 - 3-3 微細接合技術
 - 3-4 光チップレット技術
- 半導体パッケージ基板の信号品質
- 半導体パッケージ基板の電源品質
 - 5-1 Power Delivery Network(PDN)インピーダンスの概念とシミュレーションによる等価回路抽出
 - 5-2 PDNインピーダンス低減対策
 - 5-3 配線層数、配線層の厚みとPDNインピーダンスの関係
 - 5-4 Back Side Power Delivery Network(BSPDN)の概念

【WEBセミナーとは？】

- ・本講座は「Zoom」を使ったWEBセミナーです。視聴方法は「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードするか、Webブラウザから参加するかの2種類がございます。Zoom 接続テストの手順(<http://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf>)をご覧ください。
- ・タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
- ・お申込み後は、弊社よりお申し込み内容確認メールをお送りします。
- ・LIVE配信を受講される方には、Zoom視聴URLとセミナーの資料(PDF)をメールでお送りします。開始時間の10分前にご参加下さい。
- ・アーカイブ配信を受講される方は、配信開始日までにセミナー資料と動画視聴URLをメールでお送りします。

『半導体パッケージ基板』WEBセミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒☐LIVE ☐アーカイブ

会社・大学			
住 所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐Eメール ☐郵送

●Webセミナーの受講申込みについて●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。上記のLIVEかアーカイブにチェックを入れて下さい。弊社から受付完了のご連絡をいたしまして請求書をお送りいたします。

セミナーお申込み後、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席下さい。代理の方も見つからない場合、営業日(土日祝日を除く)で8日前まででしたらキャンセルをお受けします。

受講料の支払いに関してはHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>



R & D
SUPPORT CENTER

株式会社R & D支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル 7F

TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) <http://www.rdsc.co.jp/>